

RENESAS

2017年度上期

株主通信

2017年1月1日から2017年6月30日まで



BIG IDEAS
FOR EVERY SPACE



ルネサス エレクトロニクス株式会社

証券コード：6723



ごあいさつ

株主の皆様には、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
2017年度上期株主通信をお届けするにあたり、
謹んでご挨拶申し上げます。
当上期の事業概況につきましてご報告申し上げます。

代表取締役社長兼 CEO

くれ ぶん せい
呉 文 精

2017年度上期の業績と次四半期の連結業績予想

当上期の連結売上高は、前年同一期間と比べ17.5%増加し、3,758億円となりました。円高が進行したものの、2017年2月に米アナログ半導体企業Intersil Corporation(インターシル社)の買収を完了し、同社の売上が当社の連結売上として計上されたこと、また前年同一期間における2016年熊本地震の被災影響が解消したことに加え、自動車・産業向けを中心に強い成長を実現したことが、売上増の主な要因です。

当上期の連結営業利益は443億円となり、前年同一期間と比べ100億円の改善となりました。これは、主に売上高の増加によるもので、営業利益率は11.8%となりました。また、当上期の親会社株主に帰属する四半期純利益は、災害に伴う受取保険金もあり、前年同一期間と比べ268億円の増加となる、470億円となりました。

業績予想に関しては、当社グループが属する半導体業界では事業環境が短期間に大きく変化するという特徴が

あり、通期の業績予想について信頼性の高い数値を的確に算出することが困難であることから、四半期ごとの連結業績予想を開示しています。2017年度第3四半期連結累計期間の売上高は、前年同一期間と比べ986億円増の5,710億円を見込みます。営業利益は前年同一期間と比べ162億円増の650億円の見込みです。当社はこれまで、売上増と費用抑制によって、継続的に利益率を改善させてきましたが、2017年度第3四半期連結累計期間も引き続き、10%以上の営業利益率を維持することを見込んでいます。

なお、本業績予想は、第2四半期連結会計期間末において、2017年2月に買収を完了したインターシル社の取得原価の配分が完了していないため、入手可能な情報に基づき、暫定的に算定された金額です。第3四半期連結累計期間の業績数値は、インターシル社の取得原価の配分の完了により、変動する可能性があります。

配当未実施のお詫び

中間配当の実施につきましては、誠に遺憾ではござい

ますが、当上期の連結業績が四半期純利益(親会社株主に帰属する四半期純利益)を計上したものの、見送らせていただきます。株主の皆様のご期待に添えず、深くお詫び申し上げます。

当社は内部留保資金を、急激な環境の変化に対応しグローバルな競争に勝ち残るための戦略的な投資機会に充て、企業価値の向上による株主利益の増大を目指してまいります。また、長期的な視点に立ち、安定的かつ持続的な利益成長を実現し、配当の再開を目指してまいります。期末配当につきましては、現時点では未定とさせていただきます。

One Global Renesasとしての成長実現

当社は2013年10月から進めていた構造改革を終え、現在はその成果を刈り取りながら注力セグメントに経営資源を集中させ、各セグメントにおいて世界ナンバーワンになることを目指しています。

当上期はインターシル社の買収完了による事業統合も踏まえ、当社の主要事業を「自動車」、「産業」、「ブロードベースド」として、それぞれ販売・マーケティングから設計開発まで責任範囲を拡大した、3事業本部体制に移行しました。また、安定供給体制を強化するため、生産から調達まで首尾一貫したSCM(サプライチェーンマネジメント)運営の実現を狙い、「サプライチェーンマネジメント本部」を新設しました。

これら新事業体制は、日本を中心としたこれまでの事業運営から脱却し、地域にとらわれずグローバル組織とし

て運営する「One Global Renesas」を企図しており、今後の成長を確実なものとするを狙い事業運営してまいります。

当上期はこうした新体制の発足に加え、着実に成長軌道に乗るためのジャンピングボードとなり得る、二つの大きなイベントがありました。

一つは4月に開催した当社の大規模プライベート展「Renesas DevCon Japan 2017」であり、もう一つは6月に実施した大株主が保有する当社株式の売出しです。

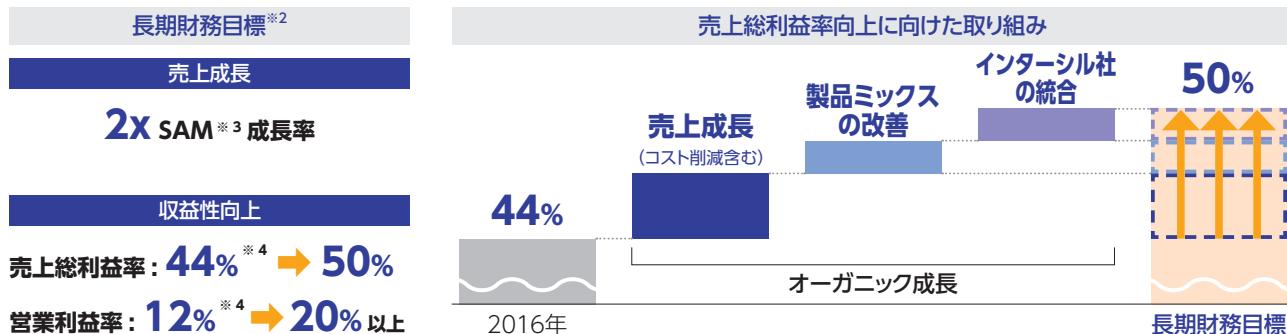
「Renesas DevCon Japan 2017」では、お客様やパートナー企業を中心とした過去最多の来場者約2,000名に対し、自動運転やAIなどでの当社の先進的な取り組みをご紹介します。当社の提供するソリューションに多大なご期待を寄せていただきました。

当社株式の売出しでは、発行済株式総数約16.7億株の内、約25%に相当する約4.2億株を国内外投資家に売出しました。これにより、当社の実質的な浮動株比率は3%から30%弱に拡大して流動性が改善し、グローバルな半導体企業として新たな一歩を踏み出したと考えています。

当社は、熾烈なグローバル競争環境においても、注力セグメントで世界ナンバーワンのポジションとなり、半導体売上は注力市場の成長率に対し2倍の成長を実現、売上総利益率50%、営業利益率20%以上を目指しています。先述した当上期の取り組みを踏まえ、今後も一層邁進してまいりますので、引き続き変わらぬご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

新たな長期財務目標

当社は2013年10月から進めていた構造改革を2016年3月期に完遂しました。現在はその成果を刈り取るとともに、注力事業に対し、戦略的かつ継続的な集中投資を行い、成長ステージに移行しつつあります。2016年11月には目指す財務指標を更新し、売上総利益率50%、営業利益率20%以上を目標に掲げました。これらは、1)市場成長率の2倍を上回る売上成長、2)製品ミックスの改善、3)2017年2月に買収を完了したインターシル社とのPMI^{*1}によって実現させる狙いです。



^{*1} Post Merger Integrationの略。M&A成立後の統合プロセスのこと。

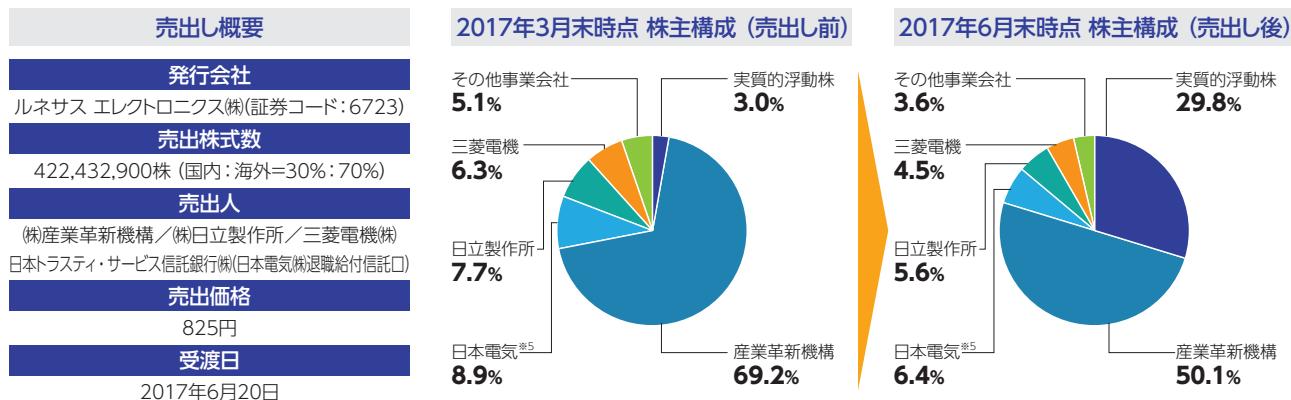
^{*2} 長期財務目標はのれんや無形固定資産の償却、株式報酬などの非支出項目及び一過性費用を除くNon-GAAP調整を反映。

^{*3} Served Available Marketの略。半導体市場全体からDRAM、フラッシュメモリ、マイクロプロセッサ、非光学センサーを除く市場。

^{*4} 2016年暦年ベースのNon-GAAPベースの数値。2016年3月期第4四半期(3ヶ月)と2016年12月期通期(9ヶ月)の業績を合算して算出。

株式の流動性向上

また、2017年6月には当社の発行済株式総数約16.7億株の内、約25%に相当する約4.2億株の国内外投資家への売出しを完了しました。これにより、当社の実質的な浮動株比率は30%弱に拡大して流動性が改善し、グローバルな半導体企業としての新たな一歩を踏み出したと考えています。



^{*5} 日本電気の退職給付信託口の日本トラスティ・サービス信託銀行保有分を含む。

売上成長を目指して

当社が強い技術・製品を持ち、今後安定的かつ高成長が期待できる分野として、「自動車」、「産業」、「ブロードベースド」を集中領域としています。これら3分野に対し、インターシル社製品も組み合わせ、デバイス、キット、プラットフォームという3つの半導体ソリューションを提供して、売上成長を目指します。

	自動車	産業	ブロードベースド
プラットフォーム価値	自動運転 統合コグピット (カーナビ + ADAS) 	産業イーサネット EtherCAT CC-Link IE EtherNet/IP 	
エコシステム ソフト・アプリ	+LDD (ヘッドアップディスプレイ) +VSP (ディスプレイネットワーク)	スマートファクトリー向け 業界標準プラットフォーム	IoTプラットフォーム +動作保証済みのソフトウェアパッケージ +エコシステム +intersil PMIC
キット価値	EVモータECU MCU + IGBT 	スマートホーム向け MCU + パワー半導体 	スマートインフラ向け メーターMCU + 通信ASSP SoC + intersil PMIC NWxMCU + intersil POL
キットデバイス システムノウハウ	xEV向けバッテリー + intersil BMIC/PMIC	(電池) (OIS)	幅広い分野に向けた MCU + ASSP + intersil PMIC
デバイス価値	Driving Steering Braking 	スマートファクトリー、スマートホーム、 スマートインフラ向け MCU、SoC/ASSP、アナログ、PMIC、パワー半導体	幅広い分野に向けた 汎用MCU、アナログ、PMIC、パワー半導体
性能・機能	自動車向け MCU、アナログ、PMIC、パワー半導体		

LDD: Laser Diode Driver VSP: Video Signal Processor MCU: Microcontroller Unit BMIC: Battery Management IC PMIC: Power Management IC
e-AI: embedded Artificial Intelligence POL: Point of Load OIS: Optical Image Stabilizer

株主価値最大化のために

継続的な利益成長に伴い、安定して創出されるフリー・キャッシュ・フローについては、成長投資・バランスシートマネジメント・株主還元等、様々な選択肢を考慮しながら、状況に応じて最適な資本配分を追求することで、株主価値の最大化を目指していきます。

成長投資	バランスシートマネジメント	株主還元
<ul style="list-style-type: none"> ■ 規律ある設備投資 ■ 更なるM&A 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 適正な財務レバレッジ ■ ROEへの配慮 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 配当の検討 ■ 自己株式取得の検討

株主価値の最大化



4月

東京で大規模プライベート展開催



4月11日に、2014年9月以来2回目となる大規模プライベート展「Renesas DevCon Japan 2017」を東京にて開催しました。今回は、「BIG IDEAS FOR EVERY SPACE」をテーマに、当社の技術・ソリューションを紹介する基調講演、セミナー・ワークショップおよび展示を実施しました。

基調講演では、当社幹部より、描くビジョンと当社半導体が果たす役割をお話しし、また「BIG IDEAS FOR GREAT CARS」として、クルマの発展に欠かせない燃費や安全性の向上などへの新たな取り組みと自動運転技術のご紹介、「BIG IDEAS FOR SMART SOCIETY」として、IoT*1やAIが普及する中で、そのエンドポイント(ネットワークの末端に位置する組み込み機器や端末)でのe-AI*2の新しい取り組みなどをご紹介します。

当日の来場者は、お客様やパートナー企業を中心に2,000名を超え、さらに進化した当社のソリューションをご体験いただき、大盛況の内に終了しました。

- * 1 IoT: Internet of Things (モノのインターネット)の略。
- * 2 e-AI: Embedded Artificial Intelligence、組み込みAI。



4月

セコムグループとIoTセキュリティ基盤で協業

当社とセコム株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社は、IoT技術を利用したサービス提供、IoT機器同士の連携を安全に行うためのセキュリティ基盤開発で協業を開始することを4月11日に発表しました。

近年、各種センサー、カメラなど様々なエンドポイント機器をインターネットに接続して情報を収集・活用するIoT技術が急速に進歩しています。しかし様々なルートで製造、販売された機器が接続されるため、事業者が信頼されたサービスを提供し、IoT

情報セキュリティ技術

組み込みセキュリティ技術



IoT認証セキュリティ基盤開発

2017年

1月

2月 通期決算発表

3月

定時株主総会

4月



4月

自動運転の新コンセプト「Renesas autonomy™」

Renesas autonomy™



自動運転のデモカー試乗会

今、自動車業界は、急速に進むエコカー、自動運転、コネクテッドカーの3つのトレンド、さらにクラウド連携による新たなサービス中心のクルマの広がりなど、新たな時代の変革期を迎えています。当社は、このような背景の中、クラウドサービス～センシング～車両制御を含む堅牢な自動運転のトータルソリューションのご要求に応える、新たなプラットフォームコンセプトとして「Renesas autonomy™」を4月11日に発表しました。

Renesas autonomyを支えるソリューション群として、世界最先端の車載MCUをベースにした車載制御やEVモータ制御ソリューション、センシングから認識/判断までカバーする自動運転ソリューション、そしてコネクテッドカーを実現するコミュニケーションゲートウェイのソリューションを、R-Carコンソーシアムに参加する約200社のパートナーと提供していきます。

4月6日にはマスコミ向けに、Renesas autonomyを体現する自動運転のデモカーの試乗会を東京で行い、レベル4*3に対応する自動運転ソリューションを体験いただきました。本デモカーは、米Ford社のLincolnをベースに、当社の米国のソリューション開発部門が中心となって、北米の自動運転分野のキーパートナーや大学との協業を通して短期間で開発しました。

- * 3 レベル4: ドライバーによる操舵などの関与が不要な完全自動運転。



4月

エンドポイントをインテリジェント化する e-AI

当社は、スマート社会の実現に向けて、IoTの末端となるエンドポイントに人工知能技術を実装する「e-AI」を注力技術の一つと位置づけ、マイクロコントローラ(MCU)やマイクロプロセッサ(MPU)にe-AIを搭載するソリューション開発に取り組んでいます。

4月11日には、深層学習(ディープラーニング)結果をMCU/MPUに実装する新機能を業界で初めて開発し、e-AIソリューションの第一弾として、6月から提供を開始することを発表しました。本ソリューションはMCU/MPU統合開発環境にAI学習環境をつなぐことで、MCU/MPUに学習結果を搭載して、エンドポイントとなる組み込み機器をインテリジェント化し、人々に豊かな生活をもたらすスマート社会を実現していきます。



5月

日立マクセルに一部事業を譲渡

機器を狙ったサイバー攻撃を防ぐために、アプリケーションサーバーから家電などのエンドポイント機器に至るまで、安全で信頼できるIoT機器同士との連携を容易に実現するIoTセキュリティ基盤が求められています。

そこで、当社は、セコムおよびセコムトラストシステムズと、IoTを構成するエンドポイント機器などについて、半導体製造からサービス提供に至る全ての期間における電子証明書、暗号技術で用いる電子鍵などの機密情報の適切な管理や配信等の機能を備えたシステムの構築や運用方法を共同で検討していきます。IoT機器の本格的なセキュリティ対策が求められる中、3社は協力してあらゆる機器がつながる「快適・便利」な世の中に欠かすことのできない「安全・安心」を提供します。

当社の生産子会社ルネサス セミコンダクタパッケージ&テストソリューションズ株式会社が手掛ける一部事業を5月1日付で日立マクセル株式会社に譲渡完了しました。今回譲渡したのは、半導体製造装置用をはじめとする各種産業用制御ボードの受託開発・製造および画像認識システムの開発・製造・販売事業です。本事業は継続して利益を創出しているものの、半導体ソリューションの設計・開発・製造・販売を主とした当社グループ事業との戦略的方向性が必ずしも一致していない状況に鑑み、当社は、本事業の更なる拡大やシナジー効果を期待できるパートナー企業を模索してきました。その結果、更なる事業の拡大を目指して本事業を活用したい日立マクセルと本事業譲渡に関し2017年1月末に最終契約を締結していました。



5-6月

当社株式の一部売出しを実施

当社の発行済株式総数約16.7億株の内、約25%に相当する約4.2億株の売出しを5月18日に発表し、6月20日に国内外の投資家への売出しを完了しました。売出し対象の株式は株式会社産業革新機構、日本電気株式会社*4、株式会社日立製作所、三菱電機株式会社が保有していた株式の一部に当たり、たとえば産業革新機構の持分比率は69.2%から50.1%に低下しました。本売出しにより、当社の実質的な流動比率は30%弱に拡大し、株主層の多様化を図りました。

*4 日本電気株式会社：同社の退職給付信託口である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の保有分の一部も売却されました。

5月 第1四半期決算発表

6月

7月

第2四半期決算発表

8月



5月

長城汽車との戦略的協業

SUV/トラック分野で中国最大の自動車メーカーである長城汽車股份有限公司と当社は、中国における新エネルギー車*5および自動運転車などの分野に向けた車載用半導体技術・ソリューションの共同開発に関して、戦略的に協業することを5月25日に発表しました。河北省保定市で行われた調印式には、両社のトップが出席し、(1)新エネルギー車の要となるシステム、(2)高速かつ堅牢な通信を実現する車載ネットワークシステム、(3)安全と快適を両立する次世代車載インフォテインメントシステム、(4)自動運転の実現に必要なADAS(先進運転支援システム)の4分野での技術開発を進めることを確認しました。両社は、新エネルギー車や自動運転車などに最先端技術を搭載し、中国の同分野での市場成長に貢献していきます。



調印式に出席した長城汽車の魏董事長(右)と当社の呉社長兼CEO(左)

*5 新エネルギー車：電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)など。



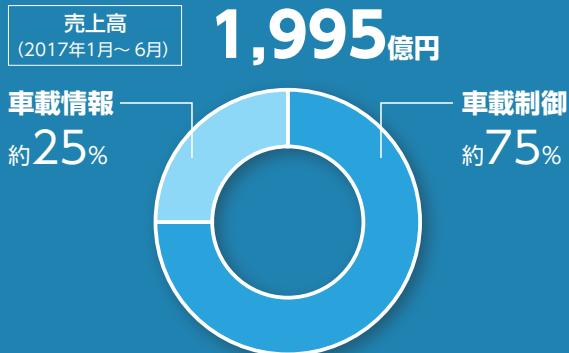
2月&7月

インターシル社を取り込んだグローバルな組織へ

2月24日に、アメリカのアナログ半導体企業Intersil Corporation(インターシル社)の買収を完了し、同社President, CEO and DirectorのNecip Sayinerが当社の執行役員常務に就任しました。また、インターシル社との事業統合も踏まえ、日本を中心としたこれまでの事業運営から脱却し、地域にとらわれずグローバル組織として運営する「One Global Renesas」を企図した真のグローバルカンパニーを目指し、7月1日付で新たな組織体制を本格始動させました。当社の主要事業については、自動車向けを担当する「オートモーティブソリューション事業本部」、産業など自動車以外の特定分野別ソリューションを基軸とする「インダストリアルソリューション事業本部」、その他汎用向けに幅広い顧客層・エンドマーケットを対象とした多様なソリューションを基軸とする「ブロードベースドソリューション事業本部」の3事業本部体制に移行しました。各事業本部では、販売・マーケティングから設計開発まで責任範囲を拡大するとともに、迅速かつ一貫した意思決定を可能としていきます。



自動車



● 提供製品

マイクロコントローラ、SoC(システム・オン・チップ)、アナログ半導体、パワー半導体

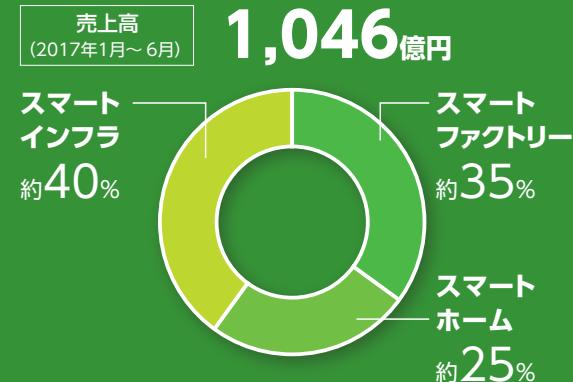
分野

車載制御：自動車のエンジンや車体などの制御向け
車載情報：カーナビゲーションなどの車載情報機器向け

■ 上期売上高概況

当上期における自動車向け事業の売上高は、前年同一期間と比べ14.4%増加し、1,995億円となりました。自動車向け事業の拡大と前年同一期間における2016年の熊本地震の被災影響が解消したことなどにより、「車載制御」および「車載情報」の売上が共に増加しました。

産業



● 提供製品

マイクロコントローラ、SoC (システム・オン・チップ)

分野

スマートファクトリー：産業機器など向け
スマートホーム：家電など向け
スマートインフラ：OA (Office Automation) 機器やネットワークインフラなど向け

■ 上期売上高概況

当上期における産業向け事業の売上高は、前年同一期間と比べ10.5%増加し、1,046億円となりました。「スマートインフラ」の売上が減少したものの、FA (Factory Automation) をはじめとする産業機器や中国向けエアコンなどの需要増により、「スマートファクトリー」および「スマートインフラ」の売上が増加しました。

ブロードベースド

売上高
(2017年1月～6月)

609億円

汎用
アナログ
半導体
約80%



汎用
マイクロ
コントローラ
約20%

● 提供製品

マイクロコントローラ、アナログ半導体

分野

分野を問わない幅広い用途に「汎用マイクロコントローラ」および「汎用アナログ半導体」を提供

■ 上期売上高概況

当上期におけるブロードベースド向け事業の売上高は、前年同一期間と比べ54.0%増加し、609億円となりました。「汎用マイクロコントローラ」の売上が減少したものの、インターシル社買収により「汎用アナログ半導体」の売上が増加しました。

■ 連結貸借対照表

	前年度末 (2016年12月31日)	当期末 (2017年6月30日)
総資産	8,231 億円	9,942 億円
純資産	4,224 億円	4,625 億円
自己資本比率	51.0%	46.2%

■ 連結損益計算書

	前年同一期間 (2016年1月1日～2016年6月30日)	当上期 (2017年1月1日～2017年6月30日)
売上高	3,198 億円	3,758 億円
半導体売上高	3,107 億円	3,669 億円
その他売上高	90 億円	89 億円
営業利益	343 億円	443 億円
経常利益	275 億円	432 億円
親会社株主に帰属する四半期純利益	203 億円	470 億円
米ドル為替レート	115 円	112 円
ユーロ為替レート	127 円	122 円

■ 連結キャッシュ・フロー計算書

	前年同一期間 (2016年1月1日～2016年6月30日)	当上期 (2017年1月1日～2017年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	446 億円	692 億円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 152 億円	△ 3,754 億円
フリー・キャッシュ・フロー	294 億円	△ 3,062 億円

(注) 億円未満を四捨五入して表示しております。
2016年度(2016年12月期)に決算期(事業年度の末日)を3月31日から12月31日に変更したことに伴い、決算期変更の経過期間である2016年度は2016年4月1日から2016年12月31日までの9か月間となっています。このため、当上期の業績は前年同一期間(2016年1月1日から2016年6月30日まで)との比較により記載しています。

■ 会社概要

商号

ルネサスエレクトロニクス株式会社

設立

2002年11月1日

(2010年4月1日ルネサス エレクトロニクス株式会社として営業開始)

資本金

100億円

主な事業

各種半導体に関する研究、開発、設計、製造、販売およびサービス

従業員数(連結)

20,138名 (2017年6月30日現在)

本社所在地

東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレスト)

■ 役員 (2017年7月1日現在)

代表取締役会長
代表取締役社長 兼 CEO
社外取締役
社外取締役
社外取締役
社外監査役
社外監査役 (非常勤)
社外監査役 (非常勤)
社外監査役 (非常勤)
執行役員常務 兼 CFO
執行役員常務
執行役員常務
執行役員常務
執行役員常務
執行役員常務 兼 Intersil Corporation, President, CEO and Director
兼 Renesas Electronics America, President
執行役員 兼 Renesas Electronics Europe, President
執行役員 兼 CTO
執行役員 兼 Renesas Electronics (China) 董事長
執行役員
執行役員
執行役員

鶴丸 哲哉
呉文 精朗
豊田 哲朗
服部 健一
岩崎 二郎
福田 和樹
清水 芳信
山崎 和義
関根 武利
柴田 英和
横田 善和
大村 隆司
大野 雅彦
川嶋 学

Necip Sayiner

Michael Hannawald

日高 秀人

真岡 朋光

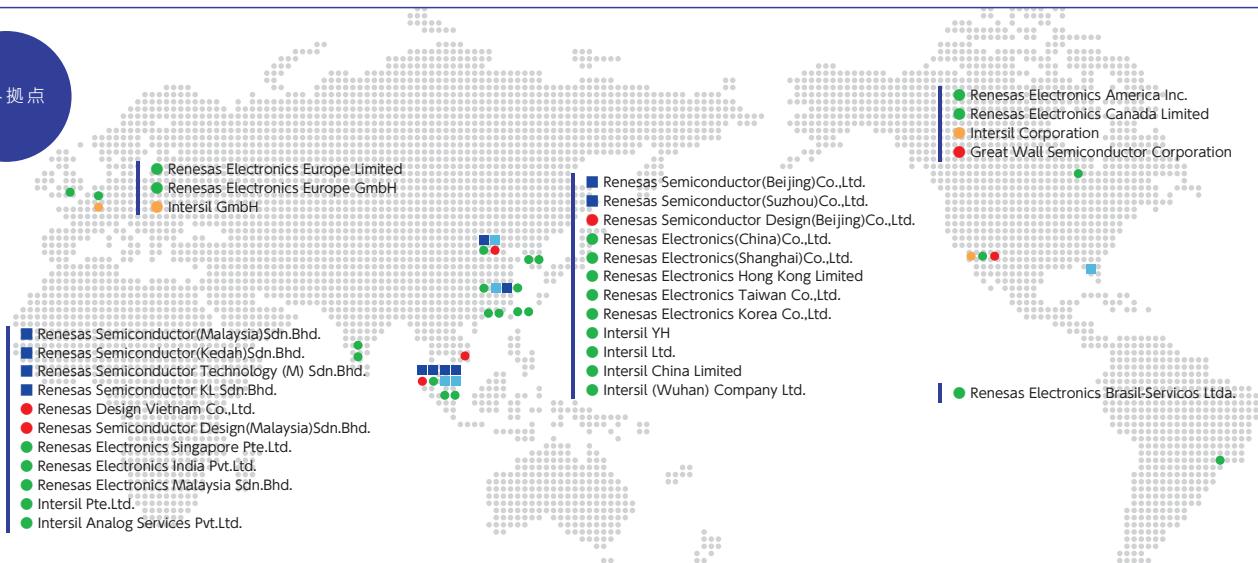
山並 裕尚

新田 啓人

吉岡 真一

■ グローバルネットワーク (2017年7月1日現在)

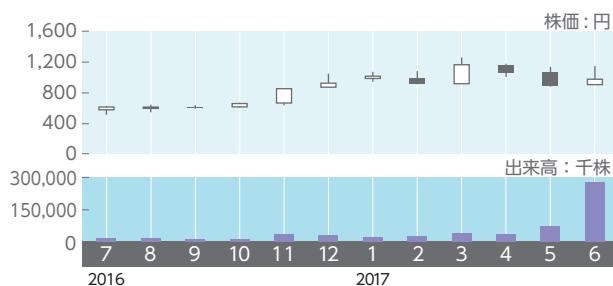
海外拠点



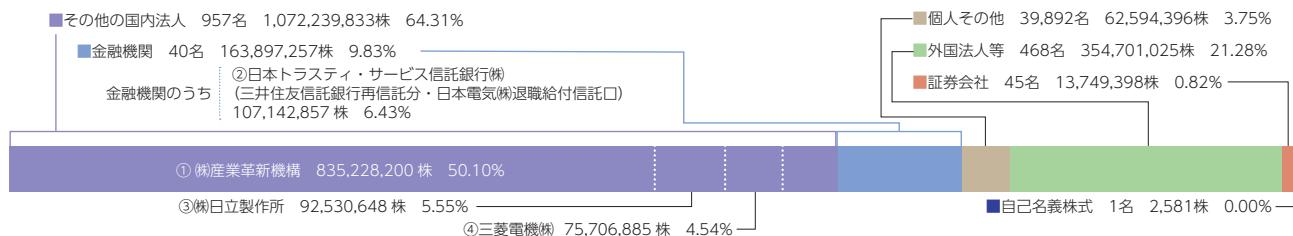
■ 株式の状況

発行可能株式総数	3,400,000,000 株
発行済株式の総数	1,667,184,490 株
株 主 数	41,403 名

■ 株価チャート (2016年7月1日～2017年6月30日)

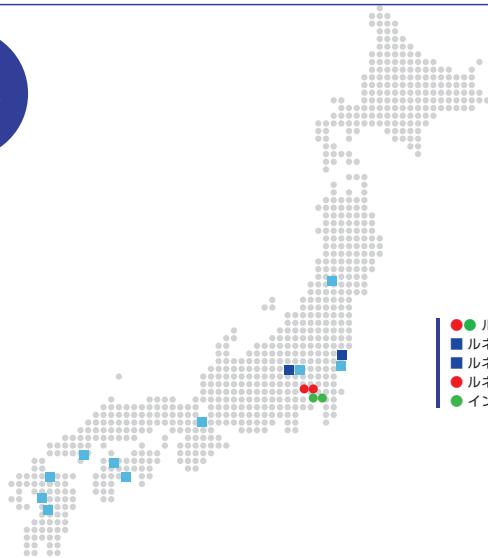


■ 株主構成



注) 持株比率 (%) は小数点第3位を四捨五入して表示しています。

国内拠点



- 製造・製造支援
- 工場所在地
- 設計・開発・応用技術
- 販売
- 事業会社

- ルネサスエレクトロニクス(株)
- ルネサスセミコンダクタマニュファクチャリング(株)
- ルネサスセミコンダクタパッケージ&テストソリューションズ(株)
- ルネサスエンジニアリングサービス(株)
- インターシル(株)

■ 株主メモ

事業年度	毎年1月1日から12月31日まで
定時株主総会	事業年度の末日の翌日から起算して3ヶ月以内
基準日	定時株主総会 毎年12月31日 期末配当金 毎年12月31日 中間配当金 毎年6月30日
単元株式数	100株
株主名簿管理人および 特別口座の口座管理機関	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
株主名簿管理人 事務取扱場所	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
郵便物送付先	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
電話照会先	フリーダイヤル 0120-782-031
インターネットURL	http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html
上場証券取引所	東京証券取引所

【特別口座について】

株券電子化前に「ほふり」(株式会社証券保管振替機構)をご利用されていなかった株主様には、株主名簿管理人である左記の三井住友信託銀行株式会社に口座(特別口座といいます)を開設しております。特別口座についてのご照会および住所変更等のお届出は、左記の電話照会先をお願いいたします。

IRサイトのご紹介

当社のIRサイトは、株主の皆様当社をより理解していただくため、IRサイトの見やすさ、各資料へのアクセスのしやすさを重視した作りになっております。

「個人投資家の皆様へ」のコーナーにおいて、トップメッセージ、当社事業概要、IR・株式情報、半導体ミニ知識など個人投資家の皆様向けの情報をまとめています。

ぜひ、ご覧下さい。

「投資家の皆様へ(IR情報)」のアドレス

<https://www.renesas.com/ja-jp/about/ir>

注目トピックス

最新資料を一括掲載

個人投資家の皆様へ

IRニュース

半導体ミニ知識



RENESAS

ルネサス エレクトロニクス株式会社
(Renesas Electronics Corporation)

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)
TEL. 03-6773-3000